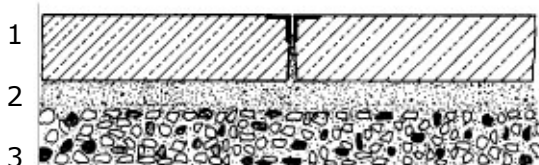


Instrukcja zabudowy płyt wielkoformatowych STELCON

Schemat gruntu wraz z płytami Stelcon



- 1 = Płyty STELCON
 2 = Podsypka (mikroniwelacja)
 3 = Podłoże

1. Podoże

- 1.1. Podstawą zabudowy płyt wielkoformatowych jest przygotowane przez inwestora wg. aktualnych reguł techniki, dobrze zagęszczone podłoże względnie podbudowa. Przy niedokładnie zagęszczonym podłożu po zabudowie płyt dojdzie może do wystąpienia nierówności, które wymagają regulacji i mogą być przyczyną ograniczenia obciążalności płyt.
- 1.2. Przy zagęszczaniu podłoża zagęszczarką górnej warstwy o grubości ok. 20 cm konieczne jest zapewnienie uzyskania wartości $EV2 \geq 120 \text{ MN/m}^2$ przy wskaźniku zagęszczania Proctora pomiędzy 98 - 103 % .
- 1.3. Przy bardzo wysoko obciążanych nawierzchniach np. dla obciążeń transportowych SLW 60 (pojazdy o ciężarze całkowitym 60 t) czy powierzchniach magazynowych z obciążeniami $\geq 150 \text{ KN/m}^2$, konieczne jest spełnienie dalekoidących założeń wraz z koniecznością przedłożenia przez inwestora dokumentacji wyników pomiarów nośności podłoża przed montażem płyt.
- 1.4. Konieczne jest przygotowanie przez inwestora wystarczającego odwodnienia powierzchni.
- 1.5. Wysokość podłoża/podbudowy to: końcowa wysokość pokrywanej powierzchni minus grubość przewidzianej płyty Esticon minus 3-5 cm mikroniwelacji.
- 1.6. W celu ustalenia dokładnej wysokości, inwestor powinien zainstalować stałe, niemożliwe do zmiany niwelacyjne punkty odnośne. Dodatkowo zabudowane powinny zostać w wystarczającej ilości pręty oznaczające.

2. Warstwa wyrównawcza (mikroniwelacja)

- 2.1. Do wykonania warstwy wyrównawczej o grubości 3-5 cm używa się gysu szlachetnego o wielkości ziarna 2/5 mm. Przy odpowiednim podłożu (np. HGT) zastosować można piasek pospółkę 2/8 mm. W halach ogrzewanych należy używać jako podsypkę gysu, gdyż zastosowana w takich wypadkach mininiwelacja z piasku ma skłonności do wysychania i może być wywiewana. W przypadku powierzchni fugowanych ograniczenie to nie musi być przestrzegane.
- 2.2. Dla powierzchni wysokoobciążanych – jak te opisane w pkt. 1.3 – należy używać jako podsypki tylko gysu szlachetnego 2/5 mm.
- 2.3. W przypadku jeśli wysokość podsypki jest wyższa niż 3 cm musi ona zostać dogęszczona zagęszczarką.
- 2.4. Na 100 m² powierzchni zużywa się na podsypkę o grubości 3–5 cm ok. 5-6 m³ gysu względnie piasku (już z uwzględnieniem ilości na zafugowanie).
- 2.5. Równość powierzchni mikroniwelacji musi odpowiadać warunkom normy DIN 18202, tabela 3 pkt. 2 .

- 3.0 Układanie płyt wielkoformatowych.
- 3.1 Układanie płyt wielkoformatowych Esticon przebiega w regule według wcześniej przygotowanego planu.
- 3.2 Pojedyncze płyty zostają osadzone w pozycji poziomej na wcześniej przygotowane podłoże. Należy przy tym pozostawić fugi o szerokości min. 5 mm.
- 3.3 Do ewentualnej regulacji i przesuwania płyt należy używać tylko szerokopowierzchniowego narzędzia. W żadnym wypadku do tych prac nie należy używać łomów czy klinów (niebezpieczeństwo odprysku kantów płyty).
- 3.4 Podsypka służy wyrównaniu nierówności zagęszczonego podłoża. Możliwe jest iż po położeniu płyt konieczne jest doregulowanie w celu uzyskania pełnowierzchniowej podpory. Efekt pełnowierzchniowego ułożenia należy sprawdzić poprzez opukanie płyt.
- 3.5 Na zakończenie należy wypełnić powierzchnie między płytowe (fugi) grysem 2/5 mm do wysokości górnej krawędzi płyt.
- 3.6 Przejżdżanie po powierzchniach odpowiednimi pojazdami przyczynia się już w trakcie zabudowy płyt do zwiększenia stopnia zagęszczenia.



Układanie płyt za pomocą wózka widłowego z zainstalowanym chwytakiem próżniowym.

UWAGA!



Nie używać walczy i zagęszczarek na płytach!

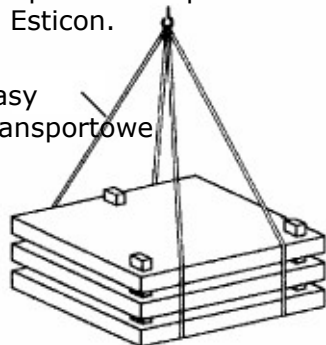
Używać odstępów i odpowiednich urządzeń do układania płyt w celu wyeliminowania możliwości uszkodzeń obrzeży płyt.



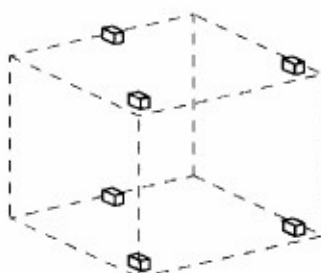
Układanie płyt za pomocą trawersy i specjalnych kluczy (dla płyt z otworami)

Sposób transportu i składowania płyt wielkoformatowych Esticon.

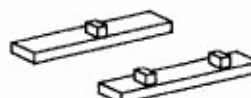
Pasy transportowe



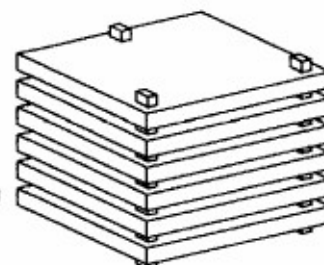
Nie podnosić i transportować więcej niż 3 płyty na raz.



Poprawne rozmieszczenie klocków dystansowych przy składowaniu płyt.



Przy miękkim podłożu pod klocki dystansowe podkładać deski



Nie składować więcej niż 10 płyt jedna na drugiej

Za szkody spowodowane błędnym postępowaniem producent nie ponosi odpowiedzialności.